การปรับปรุงคุณภาพของหัวอ่านเขียนข้อมูลของฮาร์ดดิสก์ โดยประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลอง

นายกฤษดา อัศวรุ่งแสงกุล



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2542 ISBN 974-332-602-2 ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

QUALITY IMPROVEMENT OF THE SILDER OF A HARDDISK BY APPLYING A DESIGN OF THE EXPERIMENT TECHNIQUE

Mr. Krisada Asawarungsaengkul

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Engineering in Industrial Engineering

Department of Industrial Engineering

Graduate School

Chulalongkorn University

Academic Year 1999

ISBN 974-332-602-2

การปรับปรุงคุณภาพของหัวอ่านเขียนข้อมูลของฮาร์ดดิสก์ หัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยการประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลอง นายกฤษดา อัศวรุ่งแสงกุล โดย วิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ ชุติมา อาจารย์ที่ปรึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วน หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิดุ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ศาสตราจารย์ ดร. ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ) ____อาจารย์ที่ปรึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปารเมศ ชุติมา) (รองศาสตราจารย์ ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์)

กฤษดา อัศวรุ่งแสงกุล : การปรับปรุงคุณภาพของหัวอ่านเขียนข้อมูลของฮาร์ดดิสก์ โดย ประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลอง (QUALITY IMPROVEMENT OF THE SILDER OF A HARDDISK BY APPLYING A DESIGN OF THE EXPERIMENT TECHNIQUE) อ.ที่ปรึกษา : ผศ. ดร. ปารเมศ ชุติมา; 122 หน้า. ISBN 974-332-602-2.

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดรอยบิ่นและรอยร้าวใน
กระบวนการตัดขั้นตอนสุดท้ายของการตัดหัวอ่านเขียนข้อมูลของฮาร์ดดิสก์ และหาเงื่อนไขหรือวิธีการ
ปรับปรุงที่เหมาะสม งานวิจัยเริ่มต้นจากการพิจารณาหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดรอยบิ่นและรอยร้าว
ของหัวอ่านเขียนข้อมูล โดยใช้แผนภาพแสดงเหตุและผล ทำให้สามารถเลือกปัจจัยทั้งหมด 5 ปัจจัย
ประกอบด้วย ความเร็วรอบในการตัด ความลึกของใบมีดในการตัด อัตราการป้อนตัด จำนวนครั้งในการ
เดินลับมีด และทิศทางในการตัด ปัจจัยเหล่านี้ถูกนำไปใช้ในการทดลองเบื้องต้น โดยใช้แผนการทด
ลองแฟรกชั่นนอลแบบครึ่งหนึ่งของวิธีแฟคทอเรียลโดยทุกปัจจัยมีระดับของปัจจัย 2 ระดับ จากการ
วิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติสามารถหาปัจจัยที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อการเกิดรอยบิ่นและรอยร้าว
คือ ความเร็วรอบในการตัด และทิศทางในการตัด จากนั้นทำการวิเคราะห์พบว่าสภาวะที่เหมาะสมใน
การตัด คือ ความเร็วรอบในการตัด 8,500 รอบต่อนาที และทิศทางการตัดจากด้านโพลสู่ด้านเทเปอร์

หลังจากนั้นได้ทำการทดลองเพื่อยืนยันผลพบว่า รอยบิ่นและรอยร้าวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แต่สัดส่วนของเสียที่ลดลงไม่ได้ตามต้องการ จึงได้เลือกปัจจัยที่น่าจะมีอิทธิพลต่อรอยบิ่นและรอยร้าวอีก ปัจจัยหนึ่งคือความถี่ในการลับระหว่างการใช้งาน ซึ่งกำหนดให้มีระดับของปัจจัย 3 ระดับ และใช้หลัก การวิเคราะห์ความแปรปรวนของปัจจัยเดียว หลังจากทำการทดลองพบว่า ปัจจัยนี้มีนัยสำคัญทางสถิติ และสามารถวิเคราะห์หาสภาวะที่เหมาะสมในการตัดคือ ใช้ความถี่ในการลับมีดทุกๆการตัด 1 ครั้ง จะทำ ให้จำนวนรอยบิ่นและรอยร้าวต่ำสุด จากนั้นทำการทดลองเพื่อยืนยันผล โดยเปรียบเทียบสภาวะที่เหมาะ สมกับสภาวะที่ใช้ในปัจจุบัน ผลจากการทดลองพบว่า จำนวนรอยบิ่นและรอยร้าวในสภาวะการตัดที่ได้ จากการออกแบบการทดลอง ทำให้จำนวนรอยบิ่นและรอยร้าวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

ภาควิชา	วิศวกรรมอุตสาหการ
** 111 * D 1	٩
สาขาวิชา	วศวกรรมอุตสาหการ
ปีการศึกษา	2542

ลายเมื่อชื่อบิลี	in Fin	1.11.	٨	
	L.	. 1 1 1		
ลายมือชื่ออา	จารย์ที่ปรึกษา	10	K.	
4 4	จารย์ที่ปรึกษาร่	1		
ลายมอชออา	จารยทปรกษาร	วม		

a minimization se securite medicini

3970052821 : MAJOR INDUSTRIAL ENGINEERING

ISBN 974-332-602-2.

Chip and Crack of the Slider of a Harddisk / Fractional Factorial Design / 2^k Factorial Design / Test of Hypothesis on a Proportion / Experiment with a Single Factor.

KRISADA ASAWARUNGSAENGKUL: QUALITY IMPROVEMENT OF THE SILDER OF A HARDDISK BY APPLYING A DESIGN OF THE EXPERIMENT TECHNIQUE.

THESIS ADVISOR: ASSIST. PROF. PARAMES CHUTIMA, Ph.D. 122 pp.

The objective of this research is to study the factors influencing on chips and cracks for cutting slider in the final cutting process and find some cutting conditions for improvement this process. The first step begins with the consideration of the factors influencing on chips and cracks of slider. In addition, cause and effect diagram is used to present this idea. From the diagram, five promising factors was selected including spindle speed, depth of cut, feed rate, number of pass in dressing, and direction of cut. These factors are put in the screening experiments by using One-Half Fractional of 2^k Factorial Design. The results is show that the significant factors effecting on chips and cracks are spindle speed and direction of cut. Then data are analyzed to find a better cutting condition to reduce number of chips and cracks. The cutting conditions are 8,500 rpm. for spindle speed and pole to taper for direction of cut.

After that the further experiment is conducted to confirm the result. The results show that the number of chips and cracks is significantly reduced. However the reduction in the number of chips and cracks is still not satisfactory. Thus, there may be another factors that probably effects to chips and cracks. This factor is frequency of inline-dressing, which is limited to 3 levels of frequency with single factor experiment. After conducting experiment, the result shows that the factor is statistically significant. Moreover, a better cutting condition is that frequency of pass of inline-dressing is in each cutting. Every cutting would reduce number of chips and cracks at the least. Then the confirmed experiment is conducted by statistical comparison. The result is show that the number of chips and cracks in the better cutting condition is significantly reduced.

ภาควิชา	วิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชา	วิศวกรรมอุตสาหการ
ปีการศึกษา	2542



กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ ด้วยความอนุเคราะห์ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปารเมศ ชุติมา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งท่านได้ชี้แนะแนวทางและให้คำแนะนำ ในการทำวิทยานิพนธ์เป็นอย่างดี และขอกราบขอบพระคุณ ประธานและกรรมการในการสอบ วิทยานิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร. ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ รองศาสตราจารย์ ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์ ที่ได้ช่วยเหลือให้คำ แนะนำต่าง ๆและตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี

ผู้วิจัยขอขอบคุณ คุณวรกิตต์ แสงสงวน วิศวกรของโรงงานตัวอย่าง ที่ได้ให้คำแนะ นำ และความสะดวกในการทำวิจัยครั้งนี้ ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครูบาอาจารย์ ที่ช่วยอบรมให้การศึกษาแก่ผู้วิจัยตลอดมา นอกจากนี้ขอขอบคุณ พี่น้อง เพื่อนนิสิต และท่าน ที่มิได้กล่าวไว้ในที่นี้ ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือและให้กำลังแก่ผู้ทำวิจัยเสมอมาจนสำเร็จการ ศึกษา

ท้ายนี้ หวังว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจที่จะนำไปเป็นแนว ทางการออกแบบการทดลองในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ ผลิตต่อไป

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	্গ
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	
กิตติกรรมประกาศ	
สารบัญตาราง	
สารบัญรูป	
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหา	
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	
1.3 ขอบเขตการวิจัย	
1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน	
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	
1.6 สรุปเนื้อหาโดยสังเขป	4
d a pedd v	_
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
2.1 บทนำ	
2.2 กลยุทธ์ของการทดลอง	
2.3 การประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลอง	
2.4 หลักในการออกแบบการทดลอง	
2.5 ขั้นตอนการออกแบบการทดลอง	
2.6 การใช้หลักการการทางสถิติในการทดลอง	13
2.7 การตั้งสมมติฐานในการตรวจสอบ	. 14
2.8 การวิเคราะห์ความแปรปรวน	16
2.9 ชนิดของแผนการทดลอง	21
2.10 การทดสอบสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ	25
2.11 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	26
2 12 asıl	27

		หน้า
บทที่ 3	ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดรอยบิ่นและรอยร้าวในกระบวนการตัด	27
	3.1 บทน้า	28
	3.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลด้านคน (Man)	29
	3.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลด้านวัสดุ (Material)	31
	3.4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลด้านเครื่องจักร (Machine)	34
	3.5 ปัจจัยที่มีอิทธิพลด้านวิธีการ (Method)	
	3.6 หลักการที่ใช้พิจารณาเลือกปัจจัยที่จะนำมาทำการทดลอง	
	3.7 การพิจารณาเลือกปัจจัยด้านคน (Man)	45
	3.8 การพิจารณาเลือกปัจจัยด้านวัสดุ (Material)	47
	3.9 การพิจารณาเลือกปัจจัยด้านเครื่องจักร (Machine)	49
	3.10 การพิจารณาเลือกปัจจัยด้านวิธีการ (Method)	50
	3.11 สรุป	57
บทที่ 4	การออกแบบแผนการทดลอง	58
	4.1 บทนำ	58
	4.2 กำหนดปัญหาที่น่าสนใจ	58
	4.3 การเลือกปัจจัยที่จะทำการศึกษา	59
	4.4. การเลือกตัวแปรตอบสนอง (Response Variables)	61
	4.5 การเลือกแบบการทดลอง	62
	4.6 ดำเนินการทดลอง	62
	4.7 การวิเคราะห์ข้อมูล	. 63
	4.8 สรุปผลและข้อเสนอแนะ	64
	4.9 สรุป	67
บทที่ 5	ขั้นตอนการดำเนินการทดลอง	68
	5.1 บทนำ	
	5.2 การจัดเตรียมวัตถุดิบในการทดลอง	
	5.3 การตรวจสอบข้อบกพร่องก่อนตัด	71
	5.4 กระบวนการตัดหัวอ่านเขียนข้อมูล	73
	5.5 การตรวจสอบข้อบกพร่องหลังตัด	75
	5.6 สรป.	75

	หน้า
บทที่ 6 การคำนวณและการวิเคราะห์ผลการทดลอง	76
6.2 การวิเคราะห์ผลการทดลอง	
6.3 การทดลองเพิ่มเติม	
6.4 การวิเคราะห์ผลการทดลองจากการออกแบบการทดลองเพิ่มเติม	
6.5 สรุป	100
บทที่ 7 สรุปผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะ	. 101 . 102
รายการอ้างอิง	104
ภาคผนวก	105
ประวัติผู้เขียน	122

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของปัจจัย 2 ปัจจัย (ANOVA TABLE)	18
4.1 การกำหนดปัจจัยและระดับของปัจจัย	61
4.2 ตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวน	63
4.3 สรุปแผนการออกแบบการทดลอง	64
4.4 เมตริกการออกแบบการทดลอง	66
4.5 การสุ่มอย่างสมบูรณ์ (Complete Randomization) ในการทดลอง	67
5.1 หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ	72
6.1 แสดงผลการทดลองทั้งหมด 16 สภาวะ	78
6.2 แสดงค่า Effect ของปัจจัยหลักและปัจจัยร่วม	80
6.3 แสดงค่า Effect และความน่าจะเป็น ของลำดับที่ (P _k)	81
6.4 การวิเคราะห์ควรแปรปรวนของรอยบิ่นและรอยร้าว	82
6.5 แสดงค่า Residual ที่ได้จากการคำนวณ	83
6.6 แสดงค่า Residual และความน่าจะเป็นของลำดับที่ (P _k)	84
6.7 แสดงค่าเฉลี่ยรอยบิ่นรอยร้าว ที่ความเร็วรอบในการดัดทั้งสองค่า	86
6.8 แสดงค่าเฉลี่ยรอยบิ่นรอยร้าว ที่ทิศทางในการดัดทั้งสองค่า	86
6.9 แสดงค่าเฉลี่ยของรอยบิ่นและรอยร้าว โดยพิจารณาจากปัจจัยร่วม AE	87
6.10 เงื่อนไขการดัดที่เหมาะสมจากการทดลอง	87
6.11 สรุปแผนการออกแบบการทดลองครั้งที่2	93
6.12 เมตริกการออกแบบการทดลองครั้งที่2	95
6.13 ลำดับการทดลองอย่างสุ่ม	95
6.14 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของผลการทดลอง	95

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 แสดงถึงรูปแบบของกระบวนการหรือระบบ	6
2.2 แสดงกราฟที่มีอิทธิพลของปัจจัยร่วม (Interaction)	8
2.3 กราฟที่ไม่มีอิทธิพลของปัจจัยร่วม (Interaction)	22
2.4 แสดงการหาปัจจัยที่มีความสำคัญ (Important Effects)	24
3.1 แสดงปัจจัยหลักที่มีผลต่อการเกิดรอยบิ่นและรอยร้าวบนหัวอ่านเขียนข้อมูล (Slider)	28
3.2 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุการเกิดรอยบิ่นและรอยร้าวจากปัจจัยด้านคน (Man)	30
3.3 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุการเกิดรอยบิ่นและรอยร ้ าวจากปัจจัยด้านวัสดุ (Material)	32
3.4 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุการเกิดรอยบิ่นและรอยร้าวจากปัจจัยด้านเครื่องจักร	
(Machine)	35
3.5 แสดงส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องตัดแผ่น Wafer	36
3.6 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุการเกิดรอยบิ่นและรอยร้าวจากปัจจัยด้านวิธีการทำงาน	
(Method)	38
3.7 แสดงตำแหน่งของใบมีดขณะทำการตัด	39
3.8 แสดงความลึกในการตัด	40
3.9 ภาพการทำ Truing	40
3.10 แสดงตำแหน่งของการหล่อเย็น	41
3.11 แสดงลักษณะการป้อนดัด	41
3.12 แสดงถึงการนำแผ่นโลหะมาถ่วงน้ำหนักเพื่อให้เกิดความสมดุล	42
3.13 แสดงผลของดวามดันของน้ำหล่อเย็น	44
5.1 ใบมีดตัด (Diamond Blade)	69
5.2 แผ่น Wafer ถูกตัดเป็น bar และ slider ตามลำคับ	70
5.3 แสดงแบบฟอร์มที่ใช้บันทึกข้อมูลในการตรวจสอบ	73
5.4 ร่องตัดในแผ่นWafer	74
6.1 กราฟ Normal Probability Plot ของ Effect	81
6.2 กราฟระหว่างค่า Residual กับค่าความน่าจะเป็นของลำดับที่ (P _k)	84
6.3 กราฟระหว่างค่าResidual กับ ลำดับเวลาที่ทำการทดลอง	85
6.4 กราฟระหว่างค่า Residual กับ Predicted Chip&Crack	85
6.5 กราฟค่า Residuals พล็อตคู่กับความน่าจะเป็นของลำดับที่	96

3	หน้า
6.6 กราฟระหว่างค่า Residual กับลำดับที่ของการทำการทดลอง	97
6.7 กราฟระหว่างค่าResidual กับ ค่าคาดหมายของจำนวนรอยบิ่นและรอยร้าว	97
6.8 กราฟระหว่างค่าเฉลี่ยรอยบิ่นและรอยร้าวกับระดับของปัจจัยทั้ง 3 ระดับ	98